



kingston.com/epop

ePoP

ePoP – Mémoire 'Embedded Package-on-Package' pour appareils portables

L'ePoP de Kingston fournit un composant standard JEDEC hautement intégré qui combine le stockage sur carte multimédia embarquée (eMMC) et la DRAM LPDDR (Low-Power Double Data Rate) dans une solution PoP (Package-on-Package). L'ePoP est monté directement sur un système sur puce (SoC) hôte compatible, ce qui réduit l'espace sur circuit imprimé (PCB) et garantit des performances optimales. L'ePoP est une solution idéale pour les applications à espace restreint telles que les dispositifs portables.

KEY BENEFITS

- By mounting directly on top of a host SoC, ePoP provides an ideal solution for small-form-factor applications such as wearables.
- Low-power DRAM and optimised storage firmware reduce power consumption while delivering the high performance needed for battery-powered wearable applications.
- Simplifies system design, reduces time to market and shortens the qualification cycle.
- Multiple firmware configurations available to best fit your application requirements for performance, power and life span.

SEGMENTS COMMERCIAUX



Internet des objets



Appareils portables



Appareils de réalité augmentée (AR) /
réalité virtuelle (VR)

EPOP – RÉFÉRENCES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS

ePoP basé sur LPDDR3

Part number	Capacity		Description		Package	FBGA	Operating temperature
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10 x 10 x 0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C

ePoP basé sur LPDDR4x

Part number	Capacity		Description		Package	FBGA	Operating temperature
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,85	144	-25°C ~ +85°C

*Mode pSLC pour une meilleure endurance